

智能装备产业园及配套基础设施建设项目 发行情况补充说明

一、 本项目已发行专项债券情况

发行时间	发行金额（万元）	发行利率
2020 年 9 月 10 日	15000	3.93%
2021 年 7 月 23 日	15000	3.61%
2022 年 1 月 22 日	5000	3.29%
2022 年 10 月 26 日	26600	3.13%
2023 年 5 月 24 日	10000	3.06%
2023 年 9 月 22 日	19000	3.09%
2024 年 5 月 28 日	4000	2.62%
2024 年 6 月 18 日	2500	2.53%
2024 年 8 月 8 日	4600	2.34%
2025 年 1 月 20 日	5500	2.01%
2025 年 3 月 17 日	2000	2.34%
2025 年 5 月 16 日	4000	2.13%
2025 年 6 月 23 日	5000	2.02%
2025 年 8 月 26 日	8000	2.32%
2026 年 1 月 27 日	2500	2.43%
2026 年 4 月 28 日	4000	2.42
合 计	132700	

二、 本次专项债券发行金额及年限

本次专项债券发行 17300 万元，发行期限 20 年。

三、 已完成项目总投资数

该项目已完成总投资 130000 万元。

四、其他需说明事项

(一)“一案两书”原件中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息无调整说明。

(二)市场利率、预期收入等因素无变动，对项目收益覆盖倍数无影响。

(三)其他需补充说明的事项。

根据项目建设进度情况，建设期延长至 2026 年 12 月 31 日。



出具日期: 2026 年 4 月 28 日